

ウエハ加工およびバンプボンド用 ウエハ2D+3D自動検査

人が行う官能外観検査から、設備による全自動検査へ

当社では、設備による2D（チップ表面状態/ダイシング状態検査）と3D（バンプボンド測定）の技術を組み合わせた全数検査を行うことが可能です。



検査仕様

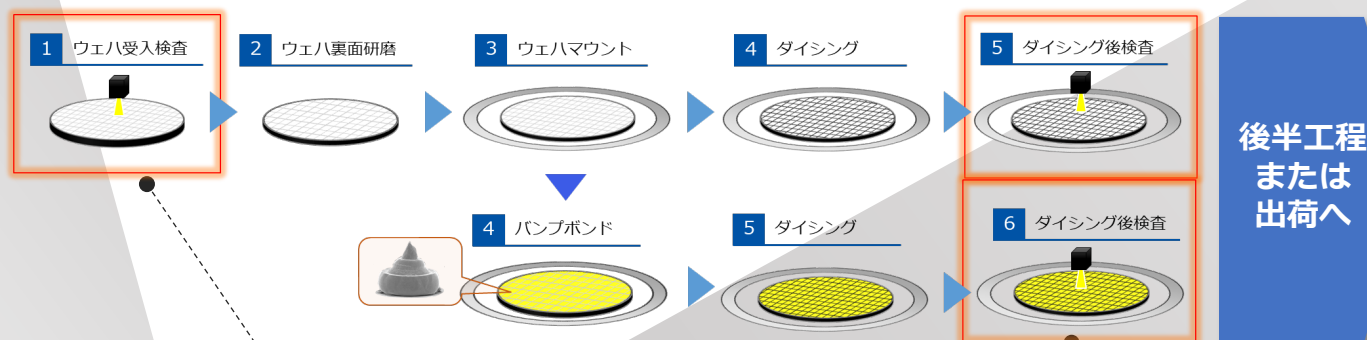
- ・ウエハの外観検査
- ・バンプの2D/3D高速高精度測定
- ・検出、測定した結果をマップデータにて出力
- ・機内クリーン度クラス10
- ・バーコード照合

対応可能製品

- ・ウエハリング：8・12Φ
- ・丸ウエハ：8・12Φ（バックメタル品も対応可）

一貫した製造・検査ライン / 完全なトレーサビリティ

当社では、ウエハ受入検査から後検査まで一貫対応しており、完全なトレーサビリティを導入しております



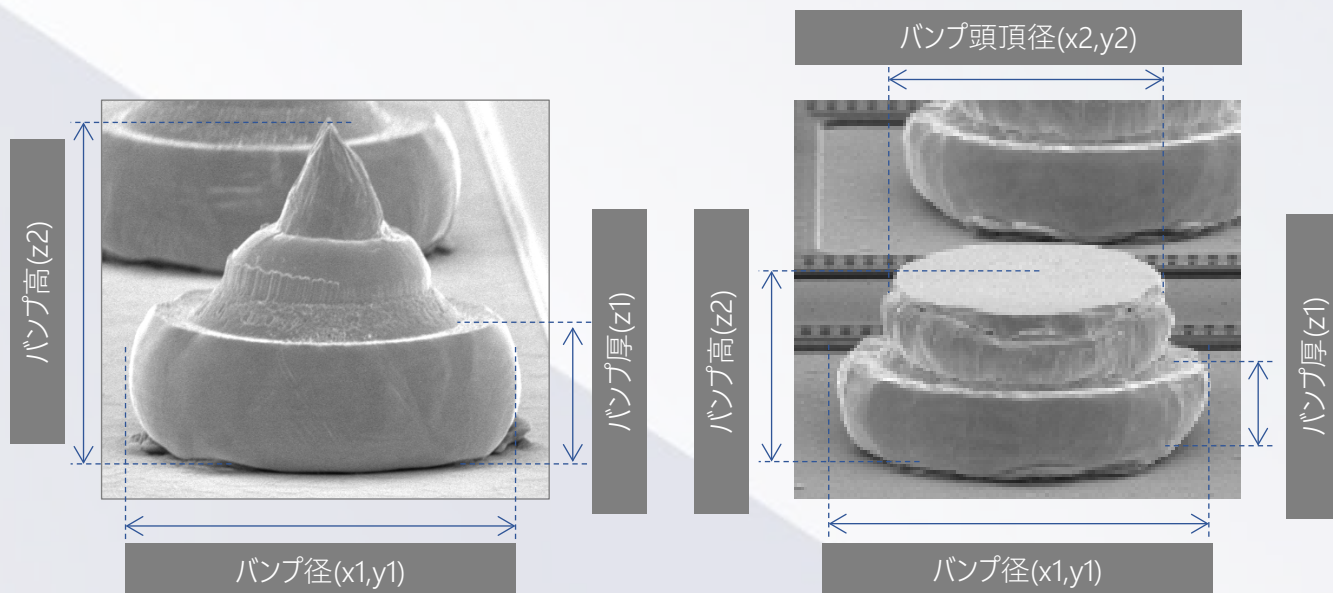
- ・ ウエハ受入段階で全数検査、履歴保存を行うため、工程で不良を検出した際、**ウエハ起因か工程起因かを切り分ける**ことが可能

- ・ 設備による自動全数検査により、**後工程への不良流出が抑止**が可能
- ・ 機内クラス10のため、**異物付着防止と全数外観検査が両立可能**

ウエハ自動外観+バンパ2D/3D測定 検査結果例



SEM（電子顕微鏡）写真



検出・測定した結果をマップデータにて出力が可能

検出・測定した結果を、マップデータとして出力が可能です。
また、不良画像の保存も可能です。

拡大図

```
! [CDATA[0011111111X
! [CDATA[11X1111111
! [CDATA[X111111111X
! [CDATA[111111X111
```

マップの出力例

[illegible]

検査結果例

